

Винахід стосується модуля (1) чіп-носій, в якому напівпровідниковий чіп (2) вмонтований у виїмку (4), виконану у тонкому носії (3). Виїмка (4) щонайменше з одного боку носія (3) накрита захисною пластинкою (5), крайові зони (6) якої закріплені на носії (3). У свою чергу напівпровідниковий чіп (2) закріплений на захисній пластинці (5).